科学研究費助成事業

亚式 20 年 6 日 1 3 日現在

研究成果報告書

機関番号: 14301
研究種目: 研究活動スタート支援
研究期間: 2016~2017
課題番号: 16H06890
研究課題名(和文)炭化珪素バイポーラトランジスタのデバイス特性モデル化と高周波電力変換回路の製作
研究課題名(英文)Device modeling of SiC bipolar junction transistors and fabrication of high-frequency power converters
研究代表者
奥田 貴史 (Okuda, Takafumi)
京都大学・工学研究科・助教
研究者番号:0 0 7 8 3 0 3 6

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 2,300,000円

研究成果の概要(和文):本研究では炭化珪素(SiC)バイポーラトランジスタ(BJT)を用いた高周波電力変換 回路の実現をめざした。まず、動作周波数1 MHzの高周波スイッチングに対応できる回路シミュレーション環境 を構築した。構築したシミュレーション環境を活用し、高周波ベース駆動回路を製作した。BJTは電流駆動回路 であるため、駆動回路に工夫を要する。この駆動回路を利用した100 W級の昇圧回路を製作した。製作した昇圧 回路は1 MHzの高い動作周波数でも94%の変換効率を実現した。SiC BJTの高周波パワースイッチングデバイスと しての可能性を示すことができたと考えられる。

研究成果の概要(英文): In this study, high-frequency power converters are investigated with silicon carbide (SiC) bipolar junction transistors (BJTs). In order to design high-frequency power converters, numerical simulation is constructed by developing device models of semiconductor devices and analyzing parasitic components of circuits. Then, a high-speed gate driving circuit is designed using the constructed numerical simulation. Since BJT is a current-controlled device, a speed-up capacitor with a base resistance is required for high-frequency switching. Finally, a 100-W DC-DC boost converter is fabricated using a SiC BJT. It is found that the power conversion efficiency is 94% at a switching frequency of 1 MHz.

研究分野:電子デバイス

キーワード:炭化珪素 バイポーラトランジスタ 電力変換回路 ベース駆動回路 高周波動作 デバイスモデリン グ スイッチング特性



1.研究開始当初の背景

電気エネルギーの利用効率向上には、パワ ーエレクトロニクスによる電力変換技術の 活用が極めて有効である。電力変換効率のさ らなる向上にむけて、根幹となるパワー半導 体デバイスの低損失化が必要である。しかし、 現在の Si 半導体デバイスは物性値に起因す る理論限界に達しつつあり、これ以上の大幅 な低損失化は見込めない。そこで、Siよりも 優れた材料物性を有するワイドギャップ半 導体 4H-SiC(4H型結晶構造の炭化ケイ素) を用いたパワーデバイスが注目されている。 理論的には導通損失を Si デバイスの約 1/300 に低減することができる。

SiC を用いた電力変換用パワートランジス タとして、電界効果トランジスタ(MOSFET) の研究開発が国内外の大学・企業により進め られてきた。しかし、SiC MOSFET はデバイ ス動作領域にSiO₂/SiCの界面を用いる構造で あり、その界面の品質が問題となっている。

そこで、申請者は別のデバイス構造である SiC npn型バイポーラトランジスタ(SiC BJT) に注目している。SiC BJT は pn 接合を用いる デバイスであり、SiO₂/SiC 界面を動作領域と して用いない。そのため、MOSFET で問題と なっている低いチャネル移動度といった課 題がなく、低導通損失で高温動作(>300) が可能である。また、MOSFET ではゲート酸 化膜容量の充放電がスイッチング特性を大 きく制限するが、SiC BJT では酸化膜の充放 電が不要であり、極めて速いスイッチング (>10 MHz)が期待される。

以上から、SiC BJT は次世代の電力変換用 デバイスとして重要な位置づけにあり、電力 変換回路に実装すべく応用研究を加速させ ることが重要である。

2.研究の目的

SiC BJT は 2000 年ごろより研究が開始され、 当初は電流増幅率 β が低いという課題があっ たが、現在では β ~100 をこえる高い増幅率が 得られるようになってきた。また、Si を用い た BJT では、破壊耐量が小さくスイッチング 時に破壊しやすいという問題(2 次降伏)があ ったが、SiC ではその優れた材料物性から十 分な破壊耐量を実現できることが分かって いる。

高性能 SiC BJT の報告がなされるようになったが、これまでの議論の中心は静特性(エミッタ接地電流-電圧特性など)であった。しかし、実際の電力変換用途ではスイッチング時の過渡特性(動特性)が重要である。高周波スイッチング特性に注目し、SiC BJT の性能を十分に引き出した電力変換回路の設計が重要である。

そこで本研究では、まず、高周波スイッチ ングに対応した回路シミュレーション環境 を構築し、1 MHz 級電力変換回路の設計基盤 を整える。そして、これをもとに昇圧回路を 設計し、SiC BJT を用いた高周波電力変換回 路の実現をめざす。

3.研究の方法

本研究は、(a) 回路シミュレーション環境 の構築、および(b) SiC BJT の高周波スイッチ ング特性をいかした電力変換回路の製作、の 2 つからなる。

1 MHz をこえる高周波動作回路ではトラン ジスタおよびダイオードの半導体デバイス モデルの見直しが必要である。これについて、 半導体物理にたちかえり、高周波領域でも適 用可能なモデルを構築する。また、スイッチ ング周波数が向上するにつれて、回路基板に 寄生するインダクタンスの影響が顕在化し てくる。そのため、これらの影響を考慮し、 高周波スイッチングを設計するためのシミ ュレーション環境構築が重要である。

次に、電力変換回路の製作では、トランジ スタを駆動するためのゲートドライバ(ベー スドライバ)の高速化が重要である。特に SiC BJT は電流駆動素子であるため、スイッチン グの際の瞬間的なベース充放電にくわえて、 定常的にベース電流を供給できるように駆 動回路を設計する必要がある。この駆動回路 を用いて、直流昇圧回路である Boost Converterを製作する。1 MHz の高周波領域で 動作させ、変換効率を評価する。

4.研究成果

(a) 回路シミュレーション環境の構築









本節で製作した Boost Converter を図1に示 す。半導体デバイスには SiC MOSFET(ROHM 社, SCT2450KE, 定格 1200 V, 10 A) と SiC SBD (ROHM 社, SCS220AE2, 定格 650 V, 10 A)を用いた。入力は 100 V とし、200 V, 50 W を出力する。チョークインダクタには 53 µH、出力キャパシタには 2.1 µF のものを 用いた。動作周波数 1 MHz では連続導通モー ドとなる。ゲートドライバには Si Labs. Si8235 を用いた。 回路シミュレータには SIMetrix を用いた。 半導体デバイスモデルについて Verilog-A を 用いて記述し、シミュレータに組み込んだ。 SiC SBD については、熱電子放出に基づくモ デルを用い、SiC MOSFET については表面電 位に基づくモデルを構築した。また、SiC BJT には Gummel Poon モデルをもとに構築した。 それぞれ、電流-電圧 (*I-V*)特性および容量-電圧 (*C-V*)特性から動特性を記述するもの である。

回路シミュレーションでは図2に示すよう に寄生成分を取り込んだ。インピーダンスア ナライザ(Keysight 4294A)をもちいて、チ ョークコイル、コンデンサなどのインピーダ ンス特性を測定し、集中定数回路で模擬した。 また、配線やトランジスタソケットに寄生す るインダクタンス成分も同様に模擬した。



図3 製作した昇圧回路におけるトランジスタのス イッチング波形(色線)と回路シミュレーション による結果(黒線)



図4 製作した昇圧回路における出力特性(色線) と回路シミュレーションによる結果(黒線)

製作した昇圧回路における SiC MOSFETの スイッチング波形を図3に、昇圧回路の出力 特性を図4に示す。スイッチングトランジス タの性能向上にともなって、5 MHz という高 周波領域でもハードスイッチングを得るこ とができた。

次に回路シミュレーションによる結果を 同じく図3および図4に示す。回路シミュレ ーションの結果が実験波形をきわめてよく 再現していることがわかった。スイッチング のスロープの部分は半導体のスイッチング 特性をおもに反映しており、その後のリンギ ング波形は回路の寄生成分との共振が主た る要因である。1 MHz をこえる高周波領域で は半導体素子のデバイスモデルだけでなく 回路の寄生成分についても十分に解析をお こなって組み込むことが重要である。



図5 再製作した昇圧回路におけるトランジスタの スイッチング波形(寄生インダクタンスを適切に 低減することでサージ電圧の大幅な低減を実現し た)

構築した回路シミュレーション環境を利 用することで、サージ電圧の低減など設計す ることが可能になる。例えば、昇圧回路にお いてはスイッチング素子と整流素子の間の 寄生インダクタンスがサージ電圧低減に重 要であること分かった。これは、スイッチン グ素子と整流素子の間をスイッチングのた びに電流が行き来するためだと考えられる。 この知見をもとに昇圧回路を再製作し、その スイッチング波形の測定結果を図 5 に示す。 ドレインソース電圧波形におけるサージ電 圧を大幅に低減することに成功した。このよ うにシミュレーション環境を活用すること で、高周波電力変換回路の設計が可能になる。

<u>(b) SiC BJT の回路応用</u>



図 6 SiC BJT のスイッチング試験回路

次に SiC BJT のスイッチング特性に注目す る。SiC BJT は電流駆動であるため、駆動回 路に工夫を要する。SiC BJT のスイッチング 試験回路を図6に示す。本研究では定常のべ ース電流をきめるベース抵抗 R_b に加えて、ス イッチング時の充放電をはやめるためにス ピードアップキャパシタ C_b を用いる。本実験 には、ベース抵抗 470 Ω 、スピードアップキ ャパシタ 0.68 nF を用いた。



図 7 SiC BJT のスイッチング試験結果



図8 駆動回路における消費電力

図 7 に SiC BJT のスイッチング試験結果を 示す。比較用として SiC MOSFET についても 測定した。BJT の駆動電圧には + 15 V/ - 15 V をもちい、MOSFET の駆動電圧には + 15 V/ - 5 V を用いた。MOSFET のゲート抵抗には 10 Ω を用いた。その結果、SiC BJT のターン オフ特性が極めて速いことが分かった。Si パ ワーBJT では伝導度変調の効果によりターン オフ特性が極めて遅いことが知られていた が、SiC ではキャリア寿命が短いため、キャ リアの蓄積時間が短く、速いターンオフが得 られたのだと考えられる。

次に駆動回路における消費電力を図8に示 す。BJT は電流駆動であるため、常にベース 電流を供給する必要があり、駆動回路の損失 が大きくなりがちである。一方で、スイッチ ング周波数の増大につれて、トランジスタの 入力容量を充放電するための電力消費が増 大する。その結果、1 MHz をこえる高周波領 域では駆動回路における損失が SiC MOSFET とほぼ同程度にまで抑えられることが分かった。



図9 SiC BJT を用いた昇圧回路におけるスイッチ ング波形の実測結果

最後に SiC BJT を用いた昇圧回路を製作し、 その特性を評価した。入力電圧を48 V とし、 出力 100 W が得られるように設計した。図 9 に製作した昇圧回路の測定結果を示す。動作 周波数は1 MHz とした。SiC BJT の優れたス イッチング特性により、入出力電力の変換効 率は 94%と極めて高い値が得られた。

まとめ

本研究では SiC BJT を用いた高周波電力変 換回路の実現をめざし、高周波スイッチング に対応できる回路シミュレーション環境を 構築した。これにより駆動周波数 1 MHz に対 応した回路設計が可能である。また、ベース 駆動回路を工夫した結果、SiC BJT の高速ス イッチングを実現した。製作した昇圧回路は 1 MHz の高い動作周波数でも 94%の変換効 率を実現した。SiC BJT の高周波パワースイ ッチングデバイスとしての可能性を示すこ とができたと考えられる。

5.主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

[雑誌論文] (計 3 件)

- 1. <u>Takafumi Okuda</u> and Takashi Hikihara, "Skew Calibration with High-Power and High-Speed Pulse Generator for Oscillocope", IEEJ Transactions on Electronics, Information and Systems, Vol. 138, pp.37-40, 2018. (査読あり)
- 2. <u>Takafumi Okuda</u>, Tsunenobu Kimoto, and Jun Suda, "A Comparative Study on Electrical Characterization of 1-kV pnp and npn SiC Bipolar Junction Transistors", Japanese Journal

of Applied Physics, Vol.57, 04FR04, 2018. (査 読あり)

3. Ryosuke Maeda, <u>Takafumi Okuda</u>, and Takashi Hikihara, "Analysis of Dynamic Characteristics of SiC Schottky Barrier Diodes at High Switching Frequency Based on Junction Capacitance", Japanese Journal of Applied Physics, Vol.57, 04FF01, 2018. (査読あり)

[学会発表](計 15 件)

- 1. <u>Takafumi Okuda</u>, Yohei Nakamura, Michihiro Shintani, Takashi Sato, and Takashi Hikihara, "Analysis of Transient Behavior of SiC Power MOSFETs Based on Surface Potential Model and Its Application to Boost Converter", 4th IEEE Workshop on Wide Bandgap Power Devices and Applications, Arkansas, United States of America, No. 1050, Nov. 8, 2016, oral. (査読あり)
- 2. Yuhei Sadanda, <u>Takafumi Okuda</u>, Takashi Hikihara, "Direct Drive of a Buck Converter by Delta-Sigma Modulation at 13.56-MHz Sampling", IEEE Workshop on Control and Modeling for Power Electronics, Stanford, California, United States of America, P05-8, July 9-12, 2017, poster. (査読あり)
- 3. Kazuki Hashimoto, <u>Takafumi Okuda</u>, and Takashi Hikihara, "A Study on Origin of Oscillation of Voltage Waveforms in Flyback Converter", 2017 Taiwan and Japan Conference on Circuits and Systems (TJCAS2017), Okayama, Japan, IC-6, Aug. 21-23, 2017, poster. (査読あり)
- 4. Ryosuke Maeda, <u>Takafumi Okuda</u>, and Takashi Hikihara, "Analysis of Dynamic Characteristics of SiC SBD at High Switching Frequency Based on Junction Capacitance", 2017 International Conference on Solid State Devices and Materials, Sendai International center, Japan, PS-5-04, Sep. 21, 2017, poster. (査読あり)
- 5. <u>Takafumi Okuda</u>, Tsunenobu Kimoto, and Jun Suda, "Investigations on Electrical Characteristics of 1-kV pnp SiC BJTs Compared with npn SiC BJT", 2017 International Conference on Solid State Devices and Materials, Sendai International center, Japan, N-5-04, Sep. 22, 2017, oral. (査 読あり)

〔図書〕(計 0 件)

[産業財産権] 出願状況(計 0 件) 取得状況(計 0 件)

〔その他〕 研究室ホームページ http://www-lab23.kuee.kyoto-u.ac.jp/ja/ 6.研究組織

(1)研究代表者
奥田 貴史 (Okuda Takafumi)
京都大学 大学院工学研究科 助教
研究者番号:00783036

(2)研究分担者 なし

(3)連携研究者 なし

(4)研究協力者 なし